(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-23183 (P2003-23183A)

(43)公開日 平成15年1月24日(2003.1.24)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FI

テーマコート*(参考) N 5F041

H01L 33/00

H01L 33/00

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 3 頁)

(21)出願番号

特願2001-206752(P2001-206752)

(22)出願日

平成13年7月6日(2001.7.6)

(71)出願人 000002303

スタンレー電気株式会社

東京都目黒区中目黒2丁目9番13号

(72)発明者 渡辺 晴志

東京都目黒区中目黒2丁目9番13号 スタ

ンレー電気株式会社内

(72)発明者 小田原 正樹

東京都目黒区中目黒2丁目9番13号 スタ

ンレー電気株式会社内

(74)代理人 100062225

弁理士 秋元 輝雄

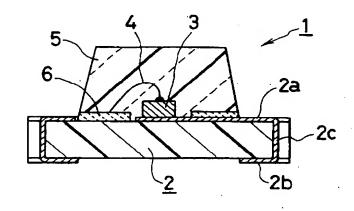
Fターム(参考) 5F041 AA03 DA19 DA20 DA36 DA44

(54) 【発明の名称】 面実装型LEDランプ

(57)【要約】

【課題】 従来のこの種の面実装型LEDランプにおいては、ガラスーエポキシ板で形成された樹脂基板が光を吸収し、例えばリードフレームにLEDチップがマウントされたLEDランプに比べて暗くなり勝ちである問題点を生じていた。

【解決手段】 本発明により、樹脂基板2上にLEDチップ3をマウントし、このLEDチップ3を透明樹脂によるケース5で覆って成る面実装型LEDランプ1において、ケース5との接合面となる前記樹脂基板の面上には白色反射膜6が設けられている面実装型LEDランプとしたことで、従来は半透明の部材で形成されていた樹脂基板2により、LEDチップから樹脂基板2方向に向かい放射されていた光が吸収され、LEDランプとしての光束利用率が低下していたのを、本発明により設けられた白色反射膜6でケース5方向に反射するものとし課題を解決する。



20





【特許請求の範囲】

【請求項1】 樹脂基板上にLEDチップをマウント し、このLEDチップを透明樹脂によるケースで覆って 成る面実装型LEDランプにおいて、前記ケースとの接 合面となる前記樹脂基板の面上には白色反射膜が設けら れていることを特徴とする面実装型LEDランプ。

1

【請求項2】 前記白色反射膜の設けられる面積は、前 記樹脂基板と前記ケースとの接合面積の50%以上とさ れていることを特徴とする請求項1の面実装型LEDラ

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は L E Dランプに関す るものであり、詳細には、電極が設けられた樹脂基板上 にLEDチップがマウントされてLEDランプとされ、 このLEDランプをプリント回路基板に搭載するときに は、ハンダ付けなどにより密着する形状として取り付け が行われる面実装型LEDランプに係るものである。

[0002]

【従来の技術】従来のこの種の面実装型LEDランプ9 0 の構成の例を示すものが図3であり、この面実装型L EDランプ90は、ガラスーエポキシ板と称されている プリント基板で形成された樹脂基板91と、前記樹脂基 板91に敷設されたパターン91a上にマウントされた LEDチップ92と、前記LEDチップ92に給電のた めの配線を行う金、或いは、アルミのワイヤー93と、 前記LEDチップ92とワイヤー93とを覆う透明樹脂 によるケース94とから構成されている。

【0003】そして、この面実装型LEDランプ90を 回路基板10に搭載するときには、前記樹脂基板91の 背面側に密着して設けられた端子91 bと、回路基板1 0上に設けられた配線パターン11とを直接にハンダ付 けなどで接続し、リード線の挿入などの手間を省くもの である。尚、パターン91aと端子91bとはスルーホ ール91 c で電気的に接続されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記した 従来の面実装型LEDランプ90においては、樹脂基板 9 1 が形成されるガラスエポキシ基板が半透明のもので あるので、LEDチップ92から放射された光の内の前 記樹脂基板91方向に向かうものは、この樹脂基板91 内に進入し吸収され失われるものとなり、ランプとして の光束利用率が低下する問題点を生じている。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、前記した従来 の課題を解決するための具体的手段として、樹脂基板上 にLEDチップをマウントし、このLEDチップを透明 樹脂によるケースで覆って成る面実装型LEDランプに おいて、前記ケースとの接合面となる前記樹脂基板の面 上には白色反射膜が設けられていることを特徴とする面

実装型LEDランプを提供することで課題を解決するも のである。

[0006]

【発明の実施の形態】つぎに、本発明を図に示す実施形 態に基づいて詳細に説明する。図1および図2に符号1 で示すものは本発明に係る面実装型LEDランプであ **り、この面実装型LEDランプ1においても、ガラス**-エポキシ板で形成された樹脂基板2と、この樹脂基板2 に敷設されたパターン2a上にマウントが行われるLE Dチップ3と、前記LEDチップ3に配線を行うための ワイヤ4と、前記LEDチップ3とワイヤ4とを覆い透 明樹脂により形成されるケース 5 とから構成されるもの である点は従来例のものと同様である。

【0007】また、前記樹脂基板2の背面側には、この 背面に密着する形状として端子2bが設けられ、該端子 2bを利用して回路基板10(ここでの図示は省略す る、従来例の図3を参照)に面実装を行うものである点 も、従来例のものと同様である、尚、図中に符号2cで 示すものはパターン2aと端子2bとを電気的に接続す るためのスルーホールである。

【0008】ここで、本発明では前記樹脂基板2の表面 側、即ち、パターン2aが設けられLEDチップ3がマ ウントされる側の面に白色反射膜 6 を設けるものであ り、この白色反射膜 6 は、前記 L E Dチップ 3 がマウン トされる部分、および、ワイヤ4が取付けられる部分を 除き、後にケース5が設けられる部分に対応して樹脂基 板2の表面側に設けられる。

【0009】そして、この白色反射膜6を設けるに当た っては、塗料(インク)のシルクスクリーン印刷で行う 方法でも良く、或いは、ホトレジスト剤の塗布とホトリ ソ法によるパターニングを行う方法でも良く、要は必要 とされる部分に白色の膜面が形成できればどの様な方法 でも良いものである。

【0010】上記のように白色反射膜6が設けられた樹 脂基板2には、従来通りにLEDチップ3がマウントさ れ、ワイヤ4による配線が行われた後には、透明エポキ シ樹脂のモールディングなどによりケース5が形成さ れ、本発明の面実装型LEDランプ1とされるものであ る。

【0011】ついで、以上に説明の構成とした本発明の 面実装型LEDランプ 1 の作用および効果について説明 を行う。前記白色反射膜6が設けられたことで前記LE Dチップ3から放射された光の内の樹脂基板2の方向に 向かう光は白色反射膜6によりケース5側に向かう反射 が行われるものとなる。

【0012】従って、樹脂基板2が半透明であること で、従来は生じていた樹脂基板2への光の吸収は生じな いものとなり、LEDチップ3から放射された光は、ほ ぼ全てがケース5方向に向かうものとなるので、面実装 型LEDランプ 1 としての光量増加が期待できるものと

なる。

【0013】尚、発明者のこの発明を成すための試作、検討の結果では、上記白色反射膜6を形成したことで、前記面実装型LEDランプ1には約10%の光量増加が認められ、前記白色反射膜6は確実に目的とする作用を奏するものであることが確認された。また、前記白色反射膜6を設けるに当たり、その敷設する面積は当然に広いことが好ましいものであるので、ケース5が形成される面積の50%以上とすることが望ましい。

[0014]

【発明の効果】以上に説明したように本発明により、樹脂基板上にLEDチップをマウントし、このLEDチップを透明樹脂によるケースで覆って成る面実装型LEDランプにおいて、前記ケースとの接合面となる前記樹脂基板の面状には白色反射膜が設けられている面実装型LEDランプとしたことで、従来は半透明の部材で形成されていた樹脂基板により、LEDチップから樹脂基板方向に向かい放射されていた光が吸収され、LEDランプとしての光束利用率が低下していたのを、本発明により設けられた白色反射膜でケース方向に反射するものと

し、LEDチップに対する光束利用率を向上させて明るい面実装型LEDランプの実現を可能とする極めて優れた効果を奏するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係る面実装型LEDランプの実施形態を示す平面図である。

【図2】 図1のA-A線に沿う断面図である。

【図3】 従来例を示す断面図である。

【符号の説明】

1 ……面実装型 L E Dランプ

2 ……樹脂基板

2 a ……パターン

2 b ……端子

2 c ……スルーホール

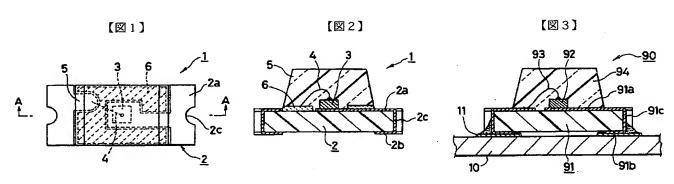
3 …… L E Dチップ

4 ……ワイヤ

5……ケース

6 ……白色反射膜

10……回路基板



THIS PAGE BLANK (USPTO)

